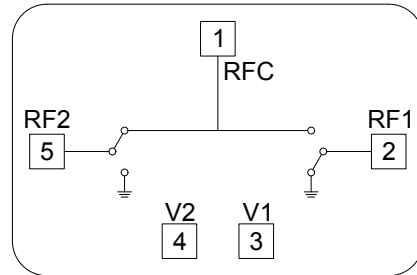


特点:

- 反射式 SP2T 开关
- 频率: DC~4GHz
- 插入损耗: 0.45dB
- 隔离度: 35dB
- 工作温度: -55~+85℃
- 芯片尺寸: 0.75×0.66×0.1mm

功能框图



性能参数: (TA=+25℃, VCtrl=0/-5V)

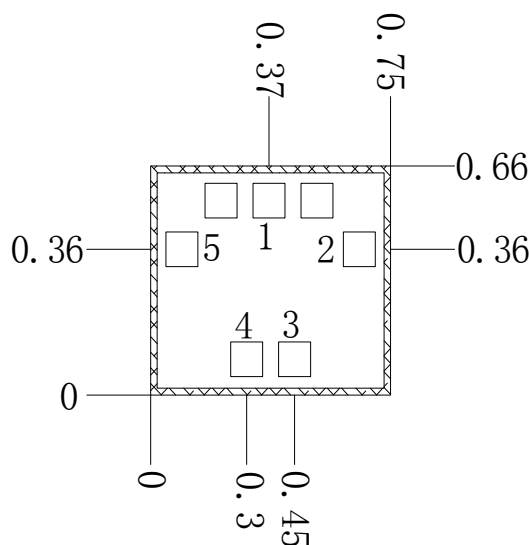
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	Zin=Zout=50Ω Pin= 0dBm VCtrl=0/-5V	DC		4	GHz	
插入损耗	IL			0.45	0.6	dB	
隔离度	ISO		32	35		dB	
输入驻波	VSWRi			1.2	2		
输出驻波	VSWRo			1.2	2		
输入 P-1	P-1			25		dBm	
开关时间	t			15		ns	

极限参数表:

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
最大输入功率	+27	dBm	贮存温度	-55~+150	℃
控制电压	低电平: 0~0.2	V			
	高电平: -4.5~-5.5				

芯片尺寸图:

单位: mm



注: 典型键合焊盘尺寸为 100*100um

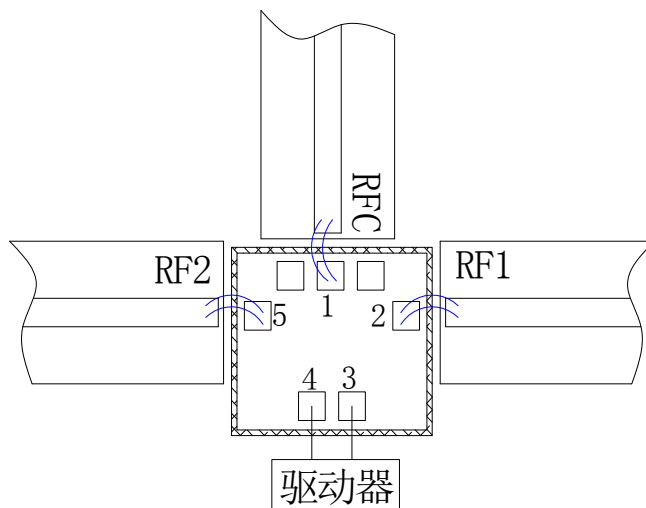
引脚定义：

引脚	定义	描述
1	RFC	射频输入，DC 耦合,需外接隔直电容
2, 5	RF1, RF2	射频输出，DC 耦合,需外接隔直电容
3, 4	V1, V2	开关控制端
芯片背面	GND	芯片背面必须接至 RF/DC 地

真值表：(0: 0V, 1: -5V)

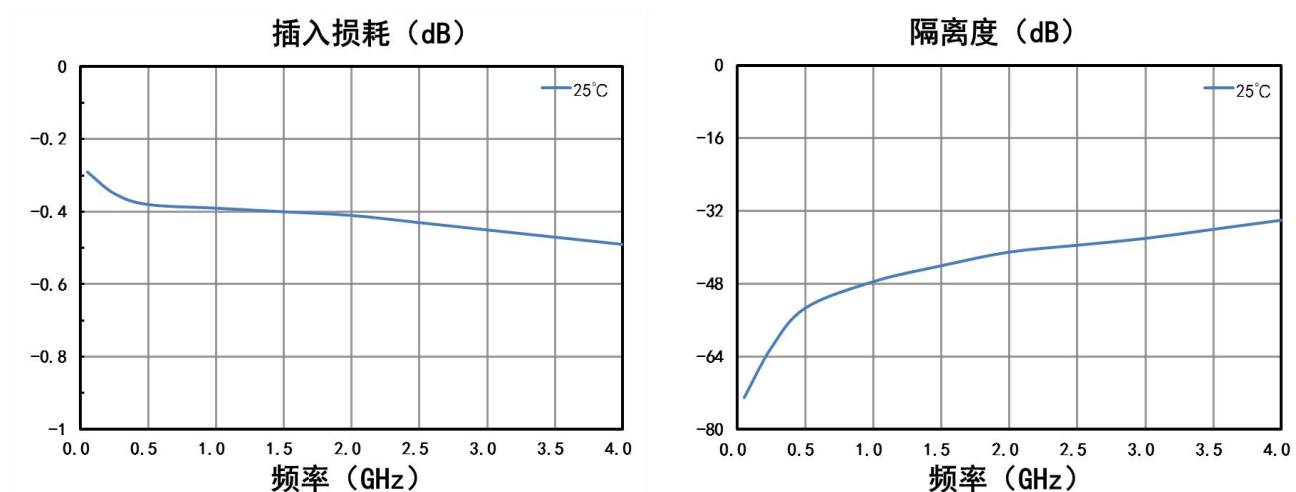
控制输入		通断状态	
V1	V2	RFC-RF1	RFC-RF2
1	0	ON	OFF
0	1	OFF	ON

推荐装配图：

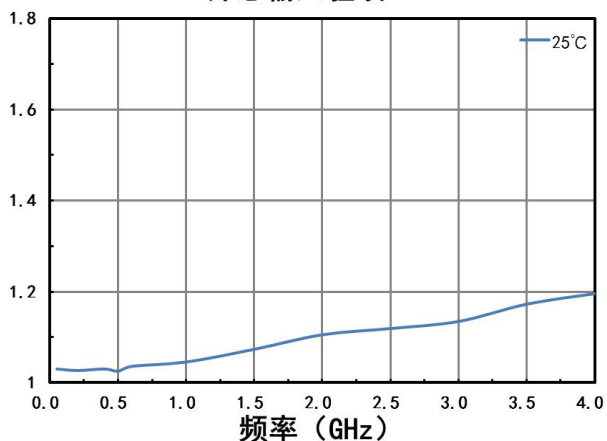


注：未标注的键合焊盘不需要连接

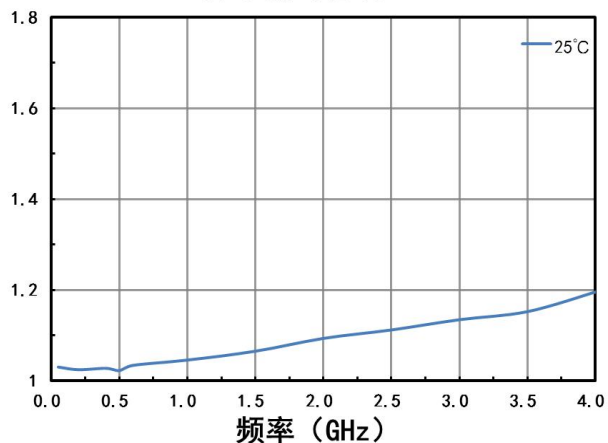
典型测试曲线：



开态输入驻波



开态输出驻波



产品使用注意事项:

1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储，在超净环境装配使用；
2. 裸芯片使用的 GaAs 材料较脆，芯片表面容易受损，不能用干或湿化学方法清洁芯片表面使用时必须小心；
3. 芯片底部用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 295℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与微带线间歇不超过 3 mil，使用 1 mil 双金丝键合，其他端口使用 1 mil 单金丝，建议金丝长度 10~16 mil；
5. 产品对静电敏感，在存储和使用过程中注意防静电；
6. 其他使用说明详见《裸芯片产品使用说明》。